

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號：1347

新聞稿

華虹半導體二零二零年第二季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2020年8月11日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零二零年六月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零二零年第二季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入 2.254 億美元，同比下降 2.0%，環比上升 11.1%。
- 毛利率 26.0%，同比下降 5.0 個百分點，環比上升 4.9 個百分點。
- 期內溢利 130 萬美元，上年同期為 4,990 萬美元，上季度為 270 萬美元。
- 母公司擁有人應佔溢利 1,780 萬美元，上年同期為 4,340 萬美元，上季度為 2,030 萬美元。
- 基本每股盈利 0.014 美元，上年同期為 0.034 美元，上季度為 0.016 美元。
- 淨資產收益率（年化）3.2%。

二零二零年第三季度指引

- 我們預計銷售收入約 2.36 億美元左右。
- 我們預計毛利率約在 22%至 24%之間。

總裁致辭

公司總裁兼執行董事唐均君先生對第二季度業績評論到：

“對於華虹半導體二零二零年第二季度的業績，我們感到非常滿意，銷售額和毛利率雙雙超過指引。第一季度的業績低點已經過去，全球半導體市場不斷釋放出復蘇訊號，中國市場表現強勁。在 IGBT、超級結、MCU 和 CIS 等多項產品的市場需求推動下，公司第二季度營收達到了 2.254 億美元，環比實現雙位數增長。與此同時，得益於產能利用率的提升以及產品組合結構的改善，我們的毛利率環比提升 4.9 個百分點，達到了 26%。”

“華虹無錫 12 英寸生產線項目自立項以來就受到了客戶與合作夥伴的關注和支持。國內外客戶的合作熱情高漲，加上優秀設計公司的不斷湧現，無錫 12 英寸新廠的整體進度也隨之提速。我們在保證既有產品高良率出貨的同時，穩步推進多個技術平台的認證工作，致力於打造多元化、綜合化的客戶解決方案。目前，12 英寸生產線已有智能卡芯片、功率器件和 CIS 產品率先交付客戶，下半年還將有 IGBT、超級結以及其他產品陸續量產出貨，以滿足新能源汽車等新興市場的需求。”

“到目前為止，新冠疫情在全球範圍內尚未得到全面有效控制，在‘保護好自己、保護好家人、保護好華虹人、保護好華虹’的方針指引下，我們堅持落實疫情防控常態化工作，與國內外設備廠商保持密切溝通，積極拓展市場深化合作，為公司中長期穩定向好的發展打下堅實基礎。在此感謝所有股東、客戶、廠商的鼎力支持，以及全體員工攻堅克難的不懈努力。展望下半年，期待新冠疫情在全球範圍內得到徹底控制，我們非常有信心必將把握機遇、再創佳績。”

電話會議公告

日期： 二零二零年八月十二日（星期三）

時間： 下午 04:00（上海 / 香港）
上午 04:00（紐約，2020 年 8 月 12 日，星期三）

發言人： 唐均君，總裁兼執行董事
王鼎，執行副總裁兼首席財務官

廣播： 該電話會議將於下述網站進行語音及幻燈片直播：

http://www.huahonggrace.com/c/investor_webcast.php 或
<https://engage.vevent.com/rt/huahongsemiconductor/index.jsp?seid=140>
(注：需要注冊才能訪問網絡直播)

電話詳細：	中國大陸	+86 400 624 0406 或 +86 800 870 0531
	中國香港	+852 3018 6768
	中國臺灣	+886 2 7703 1751
	新加坡	+65 6713 5521
	美國	+1 347 549 4095

電話會議登入名： 5675625

直播約 24 小時後，您可於 12 個月內在 http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php 網頁上，重複收聽會議。(重播密碼: Huahong)

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司（「華虹半導體」，股份代號：1347.HK）（「本公司」）是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業，特別專注於嵌入式非易失性存儲器、功率器件、模擬及電源管理和邏輯及射頻等特色工藝平台，其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員，而華虹集團是以集成電路製造為主業，擁有 8+12 英寸生產線先進工藝技術的企業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 8 英寸晶圓廠（華虹一廠、二廠及三廠），月產能約 18 萬片；同時在無錫高新技術產業開發區內建有一座 12 英寸晶圓廠（華虹七廠），月產能規劃為 4 萬片。華虹七廠於 2019 年正式落成並邁入生產運營期，成為中國大陸領先的 12 英寸特色工藝生產線，也是大陸第一條 12 英寸功率器件代工生產線。

如欲取得更多公司相關資料，請瀏覽：www.huahonggrace.com。

經營業績概要
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零二零年 第二季度 (未經審核)	二零一九年 第二季度 (未經審核)	二零二零年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	225,350	230,037	202,854	(2.0)%	11.1%
銷售成本	(166,840)	(158,614)	(160,132)	5.2%	4.2%
毛利	58,510	71,423	42,722	(18.1)%	37.0%
毛利率	26.0%	31.0%	21.1%	(5.0)	4.9
經營開支	(62,512)	(35,352)	(71,462)	76.8%	(12.5)%
其他收入淨額	12,000	24,616	20,043	(51.3)%	(40.1)%
稅前溢利	7,998	60,687	(8,697)	(86.8)%	(192.0)%
所得稅(開支)/抵免	(6,737)	(10,793)	11,442	(37.6)%	(158.9)%
期內溢利	1,261	49,894	2,745	(97.5)%	(54.1)%
淨利潤率	0.6%	21.7%	1.4%	(21.1)	(0.8)
以下各方應佔利潤:					
母公司擁有人	17,826	43,360	20,314	(58.9)%	(12.2)%
非控股權益	(16,565)	6,534	(17,569)	(353.5)%	(5.7)%
持有人應佔每股盈利					
基本	0.014	0.034	0.016	(58.8)%	(12.5)%
攤薄	0.014	0.033	0.016	(57.6)%	(12.5)%
付運晶圓(折合8吋仟片)	523	489	463	7.0%	13.0%
產能利用率 ¹	93.4%	93.2%	82.4%	0.2	11.0
淨資產收益率 ²	3.2%	8.0%	3.6%	(4.8)	(0.4)

二零二零年第二季度

- 銷售收入 2.254 億美元，同比下降 2.0%，主要由於平均售價下降，部分被晶圓銷售量上升所抵消；環比上升 11.1%，主要得益於晶圓銷售量上升。
- 銷售成本 1.668 億美元，同比上升 5.2%，主要由於晶圓銷售量上升；環比上升 4.2%，主要由於晶圓銷售量上升，部分被人工費用下降所抵消。
- 毛利率 26.0%，同比下降 5.0 個百分點，主要由於平均售價下降以及產品組合變化；環比上升 4.9 個百分點，主要得益於產能利用率提升及人工費用下降。
- 經營開支 6,250 萬美元，同比上升 76.8%，主要由於無錫工廠的研發開支及折舊費用的上升所致，環比下降 12.5%，主要由於人工費用以及研發費用下降。
- 其他收入淨額 1,200 萬美元，同比下降 51.3%，主要由於(i) 本季度取得匯兌損失，上年同期為匯兌收益，(ii) 以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產取得公允價值變動收益及利息收入減少，部分被分佔一家聯營公司溢利增加所抵消；環比下降 40.1%，主要由於政府補貼減少。
- 所得稅費用 670 萬美元，同比下降 37.6%，主要由於應課稅利潤減少。
- 期內溢利 130 萬美元，上年同期為 4,990 萬美元，上季度為 270 萬美元。
- 母公司擁有人應佔溢利 1,780 萬美元，上年同期為 4,340 萬美元，上季度為 2,030 萬美元。
- 基本每股盈利 0.014 美元，上年同期為 0.034 美元，上季度為 0.016 美元。
- 淨資產收益率(年化) 3.2%。

¹產能利用率按平均月約當產量除以總估計月產能計算。

²母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

分部經營業績
(以千美元計，營運數據除外)

	二零二零年 第二季度 (未經審核)	二零一九年 第二季度 (未經審核)	二零二零年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
華虹 8 吋					
銷售收入	215,862	230,037	200,572	(6.2)%	7.6 %
毛利	59,711	71,423	42,320	(16.4)%	41.1 %
毛利率	27.7 %	31.0 %	21.1 %	(3.3)	6.6
經營開支	(26,342)	(28,002)	(29,098)	(5.9)%	(9.5)%
稅前溢利	41,804	47,353	27,157	(11.7)%	53.9 %
息稅折舊及攤銷前利潤	74,371	80,272	60,036	(7.4)%	23.9 %
息稅折舊及攤銷前利潤率	34.5 %	34.9 %	29.9 %	(0.4)	4.6
付運晶圓(8 吋仔片)	501	489	460	2.5 %	8.9 %
華虹無錫					
銷售收入	9,488	-	2,282	N/A	315.8 %
毛利	(1,201)	N/A	402	N/A	(398.8)%
毛利率	(12.7)%	N/A	17.6 %	N/A	(30.3)
經營開支	(36,170)	(7,350)	(42,364)	392.1 %	(14.6)%
稅前溢利	(33,806)	13,334	(35,854)	(353.5)%	(5.7)%
息稅折舊及攤銷前利潤	(18,493)	13,334	(22,800)	(238.7)%	(18.9)%
息稅折舊及攤銷前利潤率	(194.9)%	N/A	(999.1)%	N/A	804.2
付運晶圓(折合 8 吋仔片)	22	-	3	N/A	633.3 %

華虹 8 吋

- 銷售收入 2.159 億美元，同比下降 6.2%，主要由於平均售價下降，部分被晶圓銷售量上升所抵消；環比上升 7.6%，主要得益於晶圓銷售量上升。
- 毛利率 27.7%，同比下降 3.3 個百分點，主要由於平均售價下降以及產品組合變化，部分被產能利用率提升所抵消；環比上升 6.6 個百分點，主要得益於產能利用率提升及人工費用下降。
- 經營開支 2,630 萬美元，同比下降 5.9%，主要由於人民幣貶值及研發費用下降所致；環比下降 9.5%，主要由於人工費用及研發費用下降。
- 稅前溢利 4,180 萬美元，上年同期為 4,740 萬美元，上季度為 2,720 萬美元。

華虹無錫

- 銷售收入 950 萬美元，四倍于上季度。
- 經營開支 3,620 萬美元，上年同期為 740 萬美元，主要由於研發費用及折舊費用增加；上季度為 4,240 萬美元，主要由於研發費用及人工費用的下降所致。
- 稅前虧損為 3,380 萬美元。
- 息稅折舊及攤銷前虧損 1,850 萬美元，較上季度減少 430 萬美元。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零二零年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第二季度 % (未經審核)	二零一九年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	216,291	96.0%	225,012	97.8%	(8,721)	(3.9)%
其他	9,059	4.0%	5,025	2.2%	4,034	80.3 %
銷售收入總額	225,350	100.0%	230,037	100.0%	(4,687)	(2.0)%

- 本季度 96.0% 的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按晶圓尺寸劃分的 銷售收入	二零二零年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第二季度 % (未經審核)	二零一九年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
8 吋晶圓	215,862	95.8%	230,037	100.0%	(14,175)	(6.2)%
12 吋晶圓	9,488	4.2%	-	-	9,488	N/A
銷售收入總額	225,350	100.0%	230,037	100.0%	(4,687)	(2.0)%

- 本季度來自於 8 吋晶圓和 12 吋晶圓的銷售收入分別為 2.159 億美元及 950 萬美元。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零二零年	二零二零年	二零一九年	二零一九年	同比	同比
	第二季度	第二季度	第二季度	第二季度		
	仟美元	%	仟美元	%	仟美元	%
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)		
中國 ³	137,558	61.0%	127,335	55.4%	10,223	8.0 %
美國	33,758	15.0%	42,042	18.3%	(8,284)	(19.7)%
亞洲 ⁴	28,560	12.7%	28,041	12.2%	519	1.9 %
歐洲	19,089	8.5%	18,246	7.9%	843	4.6 %
日本 ⁵	6,385	2.8%	14,373	6.2%	(7,988)	(55.6)%
銷售收入總額	225,350	100.0%	230,037	100.0%	(4,687)	(2.0)%

- 本季度來自於中國的銷售收入 1.376 億美元，占銷售收入總額的 61.0%，同比增長 8.0%，主要得益於邏輯產品的需求增加。
- 本季度來自於美國的銷售收入 3,380 萬美元，同比減少 19.7%，主要由於通用 MOSFET 及超級結產品的需求減少，部分被 MCU 產品的需求增加所抵消。
- 本季度來自於亞洲的銷售收入 2,860 萬美元，同比增長 1.9%，主要得益於 MCU 產品的需求增加，部分被通用 MOSFET 及邏輯產品的需求減少所抵消。
- 本季度來自於歐洲的銷售收入 1,910 萬美元，同比增長 4.6%，主要得益於智能卡芯片的需求增加。
- 本季度來自於日本的銷售收入 640 萬美元，同比減少 55.6%，主要由於邏輯及 MCU 產品的需求減少。

³包括香港。

⁴不包括中國及日本。

⁵包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

銷售收入分析

按技術平台劃分的 銷售收入	二零二零年	二零二零年	二零一九年	二零一九年	同比	同比
	第二季度	第二季度	第二季度	第二季度		
	仟美元	%	仟美元	%	仟美元	%
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)		
嵌入式非易失性存儲器	76,866	34.1%	79,583	34.6%	(2,717)	(3.4)%
分立器件	86,779	38.5%	92,487	40.2%	(5,708)	(6.2)%
模擬與電源管理	31,555	14.0%	33,371	14.5%	(1,816)	(5.4)%
邏輯及射頻	26,712	11.9%	21,606	9.4%	5,106	23.6 %
獨立非易失性存儲器	3,155	1.4%	2,709	1.2%	446	16.5 %
其他	283	0.1%	281	0.1%	2	0.7 %
銷售收入總額	225,350	100.0%	230,037	100.0%	(4,687)	(2.0)%

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 7,690 萬美元，同比減少 3.4%，主要由於智能卡芯片的需求減少，部分被 MCU 產品的需求增加所抵消。
- 本季度分立器件銷售收入 8,680 萬美元，同比減少 6.2%，主要由於超級結產品的需求減少，部分被 IGBT 產品的需求增加所抵消。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 3,160 萬美元，同比減少 5.4%，主要由於 LED 照明及模擬產品的需求減少，部分被其他電源管理產品的需求增加所抵消。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 2,670 萬美元，同比增長 23.6%，主要得益於邏輯產品的需求增加，部分被射頻產品的需求減少所抵消。
- 本季度獨立非易失性存儲器銷售收入 320 萬美元，同比增長 16.5%，主要得益於 EEPROM 產品的需求增加。

銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零二零年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第二季度 % (未經審核)	二零一九年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
0.13 μ m 及以下	76,322	33.9%	73,783	32.1%	2,539	3.4 %
0.15 μ m 及 0.18 μ m	33,971	15.1%	25,155	10.9%	8,816	35.0 %
0.25 μ m	4,009	1.8%	2,133	0.9%	1,876	88.0 %
0.35 μ m 及以上	111,048	49.2%	128,966	56.1%	(17,918)	(13.9)%
銷售收入總額	225,350	100.0%	230,037	100.0%	(4,687)	(2.0)%

- 本季度 0.13 μ m 及以下工藝技術節點的銷售收入 7,630 萬美元，同比增長 3.4%，主要得益於 MCU 及邏輯產品的需求增加，部分被智能卡芯片的需求減少所抵消。
- 本季度 0.15 μ m 及 0.18 μ m 工藝技術節點的銷售收入 3,400 萬美元，同比增長 35.0%，主要得益於 MCU、模擬及邏輯產品的需求增加。
- 本季度 0.25 μ m 工藝技術節點的銷售收入 400 萬美元，同比增長 88.0%，主要得益於邏輯產品的需求增加。
- 本季度 0.35 μ m 及以上工藝技術節點的銷售收入 1.110 億美元，同比減少 13.9%，主要由於超級結、智能卡芯片及模擬產品的需求減少。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零二零年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第二季度 % (未經審核)	二零一九年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
電子消費品	133,727	59.3%	147,160	64.0%	(13,433)	(9.1)%
工業及汽車	56,046	24.9%	44,285	19.3%	11,761	26.6 %
通訊	27,455	12.2%	28,134	12.2%	(679)	(2.4)%
計算機	8,122	3.6%	10,458	4.5%	(2,336)	(22.3)%
銷售收入總額	225,350	100.0%	230,037	100.0%	(4,687)	(2.0)%

- 本季度電子消費品作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 1.337 億美元，占銷售收入總額的 59.3%，同比減少 9.1%，主要由於智能卡芯片的需求減少。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 5,600 萬美元，同比增長 26.6%，主要得益於 MCU、模擬、邏輯、智能卡芯片及 IGBT 產品的需求增加，部分被超級結產品的需求減少所抵消。
- 本季度通訊產品銷售收入 2,750 萬美元，同比減少 2.4%，主要由於智能卡芯片及通用 MOSFET 產品的需求減少，部分被邏輯產品的需求增加所抵消。
- 本季度計算機產品銷售收入 810 萬美元，同比減少 22.3%，主要由於通用 MOSFET 產品的需求減少。

產能⁶及產能利用率

晶圓廠(仟片晶圓每月)	二零二零年 第二季度 (未經審核)	二零一九年 第二季度 (未經審核)	二零二零年 第一季度 (未經審核)
1 號晶圓廠 (200mm)	65	65	65
2 號晶圓廠 (200mm)	60	60	60
3 號晶圓廠 (200mm)	53	50	53
7 號晶圓廠 (300mm)	10	-	10
合計折合 8 吋產能	201	175	201
產能利用率 (200mm)	100.4%	93.2%	91.9%
產能利用率 (300mm)	38.3%	-	6.9%
總體產能利用率	93.4%	93.2%	82.4%

- 本季度末月產能達 201,000 片 8 吋等值晶圓。總體產能利用率為 93.4%，環比增加 11.0 個百分點。

付運晶圓

折合 8 吋仟片晶圓	二零二零年 第二季度 (未經審核)	二零一九年 第二季度 (未經審核)	二零二零年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	523	489	463	7.0 %	13.0 %

- 本季度付運晶圓 523,000 片，同比增加 7.0%，環比增加 13.0%。

經營開支分析

以千美元計	二零二零年 第二季度 (未經審核)	二零一九年 第二季度 (未經審核)	二零二零年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	1,925	1,979	2,301	(2.7)%	(16.3)%
管理費用 ⁷	60,587	33,373	69,161	81.5 %	(12.4)%
經營開支	62,512	35,352	71,462	76.8 %	(12.5)%

- 經營開支 6,250 萬美元，同比上升 76.8%，主要由於無錫工廠的研發開支及折舊費用的上升所致，環比下降 12.5%，主要由於人工費用以及研發費用下降。

⁶ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

⁷ 管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

其他收入淨額

以千美元計	二零二零年 第二季度 (未經審核)	二零一九年 第二季度 (未經審核)	二零二零年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	3,071	3,225	3,098	(4.8)%	(0.9)%
利息收入	2,960	5,661	2,710	(47.7)%	9.2%
以公允價值計量且變動計入當期損益 的金融資產之公允價值變動收益	1,658	7,627	3,454	(78.3)%	(52.0)%
匯兌(損失)/收益	(361)	7,589	1,352	(104.8)%	(126.7)%
分佔一家聯營公司溢利	4,362	627	2,896	595.7%	50.6%
財務費用	(301)	(309)	(317)	(2.6)%	(5.0)%
政府補貼	453	82	6,607	452.4%	(93.1)%
其他	158	114	243	38.6%	(35.0)%
其他收入淨額	12,000	24,616	20,043	(51.3)%	(40.1)%

- 其他收入淨額 1,200 萬美元，同比下降 51.3%，主要由於(i) 本季度取得匯兌損失，上年同期為匯兌收益，(ii) 以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產取得公允價值變動收益及利息收入減少，部分被分佔一家聯營公司溢利增加所抵消；環比下降 40.1%，主要由於政府補貼減少。

現金流量分析

以千美元計	二零二零年 第二季度 (未經審核)	二零一九年 第二季度 (未經審核)	二零二零年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所得/(用)現金流量淨額	101,847	20,659	(6,639)	393.0%	(1,634.1)%
投資活動所得/(用)現金流量淨額	81,493	(280,795)	51,368	(129.0)%	58.6%
融資活動所(用)/得現金流量淨額	(3,230)	(52,974)	1,662	(93.9)%	(294.3)%
外匯匯率變動影響淨額	545	(7,471)	(4,375)	(107.3)%	(112.5)%
現金及現金等價物變動影響淨額	180,655	(320,581)	42,016	(156.4)%	330.0%

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 1.018 億美元，上年同期為 2,070 萬美元，主要由於收到增值稅退稅款。
- 投資活動所得現金流量淨額 8,150 萬美元，其中(i) 贖回以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產投資 1.870 億美元，(ii) 贖回定期存款投資 7,000 萬美元，及(iii) 利息收入 260 萬美元；部分被固定資產及無形資產投資支出 1.781 億美元所抵消。
- 融資活動所用現金流量淨額 320 萬美元，其中(i) 償還銀行貸款本金 210 萬美元，(ii) 租賃負債支出 110 萬美元，及(iii) 支付利息 10 萬美元，部分被發行股份收到款項 10 萬美元所抵消。

資本結構

以千美元計	於六月三十日 二零二零年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二零年 (未經審核)
資產總額	3,575,890	3,540,298
負債總額	526,107	498,079
所有者權益總額	3,049,783	3,042,219
資產負債率 ⁸	14.7%	14.1%

資本開支

以千美元計	二零二零年 第二季度 (未經審核)	二零二零年 第一季度 (未經審核)
華虹 8 吋	33,272	31,409
華虹無錫	144,801	169,141
合計	178,073	200,550

- 本季度資本開支 1.781 億美元，其中 1.448 億美元用於華虹無錫。

⁸ 資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以千美元計	於六月三十日 二零二零年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二零年 (未經審核)
存貨	176,856	154,736
貿易應收款項及應收票據	135,518	156,223
預付款項、按金及其他應收款項	66,174	133,057
應收關聯方款項	11,588	10,593
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產	84,759	270,167
已凍結存款及定期存款	766	70,765
現金及現金等價物	698,957	518,302
流動資產總額	1,174,618	1,313,843
貿易應付款項	92,607	95,510
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	318,489	268,710
計息銀行借款	4,238	4,234
租賃負債	3,757	2,977
政府補助	40,105	40,017
應付關聯方款項	13,467	16,531
應付所得稅	14,292	31,431
流動負債總額	486,955	459,410
淨營運資金	687,663	854,433
速動比率	2.0x	2.5x
流動比率	2.4x	2.9x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	59	73
存貨周轉天數	89	83

- 存貨由上季度末的 1.547 億美元上升至本季度末的 1.769 億美元，主要由原材料及產成品庫存增加。
- 貿易應收款項及應收票據由上季度末的 1.562 億美元下降至本季度末的 1.355 億美元，主要由於上季度銷售收入因新冠疫情的影響有所下降。
- 預付款項、按金及其他應收款項由上季度末的 1.331 億美元下降至本季度末的 6,620 萬美元，主要由於收到增值稅退稅款。
- 以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產由上季度末的 2.702 億美元下降至本季度末的 8,480 萬美元，主要由於理財產品的贖回。
- 已凍結存款及定期存款由上季度末的 7,080 萬美元下降至本季度末的 80 萬美元，主要定期存款的贖回。
- 其他應付款項、預收賬款及暫估費用由上季度末的 2.687 億美元上升至本季度末的 3.185 億美元，主要由於應付資本性開支增加。
- 應付所得稅由上季度末的 3,140 萬美元下降至本季度末的 1,430 萬美元，主要由於支付 2019 年度所得稅。
- 本季度末淨營運資金 6.877 億美元，流動比率 2.4。
- 本季度末貿易應收款項及應收票據周轉天數 59 天。
- 本季度末存貨周轉天數 89 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com。

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於六月三十日 二零二零年 (未經審核)	於六月三十日 二零一九年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二零年 (未經審核)
銷售收入	225,350	230,037	202,854
銷售成本	(166,840)	(158,614)	(160,132)
毛利	58,510	71,423	42,722
其他收入及收益	8,303	24,302	17,464
銷售及分銷費用	(1,925)	(1,979)	(2,301)
管理費用	(60,587)	(33,373)	(69,161)
其他費用	(364)	(4)	-
財務費用	(301)	(309)	(317)
分佔一家聯營公司溢利	4,362	627	2,896
稅前溢利	7,998	60,687	(8,697)
所得稅(開支)/抵免	(6,737)	(10,793)	11,442
期內溢利	1,261	49,894	2,745
以下各方應佔利潤:			
母公司擁有人	17,826	43,360	20,314
非控股權益	(16,565)	6,534	(17,569)
持有人應佔每股盈利			
基本	0.014	0.034	0.016
攤薄	0.014	0.033	0.016
用於計算持有人應佔每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,291,439,564	1,285,237,562	1,290,612,948
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,300,881,564	1,299,346,562	1,303,317,948

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於六月三十日 二零二零年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二零年 (未經審核)	於六月三十日 二零一九年 (未經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	1,790,860	1,659,799	1,037,724
使用權資產	75,810	74,809	75,484
投資物業	166,154	166,023	170,939
無形資產	32,201	10,766	12,198
於聯營公司的投資	79,335	74,898	64,900
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	204,658	204,497	208,008
長期預付款項	42,100	14,721	90,270
應收關聯方款項	1,994	13,629	6,908
遞延稅項資產	8,160	7,313	7,429
非流動資產總額	2,401,272	2,226,455	1,673,860
流動資產			
存貨	176,856	154,736	139,128
貿易應收款項及應收票據	135,518	156,223	147,771
預付款項、按金及其他應收款項	66,174	133,057	72,067
應收關聯方款項	11,588	10,593	4,366
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產	84,759	270,167	658,306
已凍結存款及定期存款	766	70,765	14,724
現金及現金等價物	698,957	518,302	834,678
流動資產總額	1,174,618	1,313,843	1,871,040
流動負債			
貿易應付款項	92,607	95,510	76,966
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	318,489	268,710	267,047
計息銀行借款	4,238	4,234	4,364
租賃負債	3,757	2,977	1,381
政府補助	40,105	40,017	55,335
應付關聯方款項	13,467	16,531	12,688
應付所得稅	14,292	31,431	18,908
流動負債總額	486,955	459,410	436,689
流動資產淨額	687,663	854,433	1,434,351
總資產減流動負債	3,088,935	3,080,888	3,108,211
非流動負債			
計息銀行借款	19,069	21,171	24,001
租賃負債	16,889	15,837	16,653
遞延稅項負債	3,194	1,661	8,203
非流動負債總額	39,152	38,669	48,857
淨資產	3,049,783	3,042,219	3,059,354
權益和負債權益			
股本	1,971,748	1,968,961	1,961,742
儲備	286,489	265,907	234,763
本公司擁有人應佔權益	2,258,237	2,234,868	2,196,505
非控股權益	791,546	807,351	862,849
權益總額	3,049,783	3,042,219	3,059,354

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於六月三十日	於六月三十日	於三月三十一日
	二零二零年 (未經審核)	二零一九年 (未經審核)	二零二零年 (未經審核)
經營活動所得/(用)現金流量:			
稅前溢利/(損失)	7,998	60,687	(8,697)
折舊及攤銷	47,579	32,610	45,616
應佔聯營公司溢利	(4,362)	(627)	(2,896)
營運資金的變動及其它	50,632	(72,011)	(40,662)
經營活動所得/(用)現金流量淨額	101,847	20,659	(6,639)
投資活動所得/(用)現金流量:			
購買物業、廠房、設備及無形資產項目	(178,073)	(223,053)	(200,550)
其他投資活動所得/(用)現金流量	259,566	(57,742)	251,918
投資活動所得/(用)現金流量淨額	81,493	(280,795)	51,368
融資活動所(用)/得現金流量:			
發行股份所得收益	17	537	3,817
向股東支付股息	-	(37,042)	-
已凍結存款的增加	-	(13,943)	-
償還銀行貸款	(2,119)	(2,182)	-
償還租賃負債	(1,050)	(249)	(2,078)
已付利息	(78)	(95)	(77)
融資活動所(用)/得現金流量淨額	(3,230)	(52,974)	1,662
現金及現金等價物增加/(減少)淨額	180,110	(313,110)	46,391
外匯匯率變動影響淨額	545	(7,471)	(4,375)
期初現金及現金等價物	518,302	1,155,259	476,286
期末現金及現金等價物	698,957	834,678	518,302

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張素心(董事長)
唐均君(總裁)

非執行董事

杜洋
森田隆之
王靖
葉峻

獨立非執行董事

張祖同
王桂壩太平紳士
葉龍蜚

承董事會命

華虹半導體有限公司
張素心
董事長兼執行董事

中國 香港
二零二零年八月十一日